



kingston.com/epop

ePoP

ePoP – Memori Kemasan-dalam-Kemasan Tertanam untuk Perangkat yang Dapat Dikenakan

ePoP (Embedded Package-on-Package) Kingston mencakup komponen standar JEDEC yang sangat terintegrasi, yang menggabungkan penyimpanan Kartu MultiMedia Tertanam (eMMC) dan DRAM Laju Data Ganda Berdaya Rendah (LPDDR) ke dalam solusi Kemasan-dalam-Kemasan (Package-on-Package/PoP). ePoP dipasang langsung di atas host yang kompatibel dengan System pada Chip (SoC), yang mengurangi ruang Papan Sirkuit Cetak (PCB), serta memastikan performa optimal. ePoP adalah solusi yang ideal untuk aplikasi terbatas ruang, seperti perangkat yang dapat dikenakan.

KEUNGGULAN UTAMA

- Dengan pemasangan langsung di atas host SoC, ePoP menyediakan solusi yang ideal untuk aplikasi form faktor kecil, seperti perangkat yang dapat dikenakan.
- DRAM Berdaya Rendah dan firmware penyimpanan yang dioptimalkan mengurangi konsumsi daya sekaligus memberikan performa tinggi yang diperlukan untuk aplikasi pada perangkat yang dapat dikenakan dan bertenaga baterai.
- Menyederhanakan desain sistem, mengurangi waktu untuk pemasaran, dan memperpendek siklus kualifikasi.
- Tersedia beberapa konfigurasi firmware yang sangat cocok dengan persyaratan aplikasi Anda dalam hal performa, daya, dan masa pakai.

SEGMENT PASAR



IoT



Perangkat yang Dapat Dikenakan



Perangkat Augmented Reality (AR)/Virtual Reality (VR)

NOMOR KOMPONEN DAN SPESIFIKASI EPOP

ePoP berbasis LPDDR3

Nomor Komponen	Kapasitas		Standar		Kemasan (mm)	FBGA	Suhu Operasi
	NAND (GB)	DRAM (Gb)	eMMC	DRAM			
04EP04-N3GM627	4	4	5,0	LPDDR3	10x10x0,8	136	-25°C ~ +85°C
04EP08-N3GM627	4	8	5,0	LPDDR3	10x10x0,85	136	-25°C ~ +85°C
08EP08-N3GTC32*	8	8	5,1	LPDDR3	10x10x0,85	136	-25°C ~ +85°C
32EP08-N3GTC32	32	8	5,1	LPDDR3	10x10x0,85	136	-25°C ~ +85°C

LPDDR4x based ePoP

Nomor Komponen	Kapasitas		Standar		Kemasan (mm)	FBGA	Suhu Operasi
	NAND (GB)	DRAM (Gb)	eMMC	DRAM			
08EP08-M4ETC32*	8	8	5,1	LPDDR4x	8x9,5x0,8	144	-25°C ~ +85°C
08CP08-M4ETC32*	8	8	5,1	LPDDR4x	8x9,5x0,85	144	-25°C ~ +85°C
16EP08-M4ETC32	16	8	5,1	LPDDR4x	8x9,5x0,8	144	-25°C ~ +85°C
32EP08-M4ETC32	32	8	5,1	LPDDR4x	8x9,5x0,8	144	-25°C ~ +85°C
16EP16-M4FTC32	16	16	5,1	LPDDR4x	8x9,5x0,8	144	-25°C ~ +85°C
32EP16-M4FTC32	32	16	5,1	LPDDR4x	8x9,5x0,8	144	-25°C ~ +85°C
32CP16-M4FTC32	32	16	5,1	LPDDR4x	8x9,5x0,85	144	-25°C ~ +85°C

*Mode pSLC untuk ketahanan yang lebih tinggi

